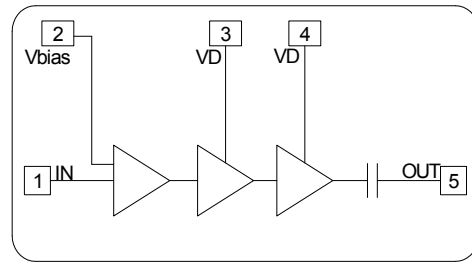


特点:

- 频率: 0.8~4GHz
- 增益: 36dB
- 输出-1dB 压缩点: 20dBm
- 单电源工作: +5V@115mA
- 工作温度: -55~+85°C
- 芯片尺寸: 1.57×1.25×0.1mm

功能框图

性能参数: (TA=+25°C, VD=+5V, ID=115mA)

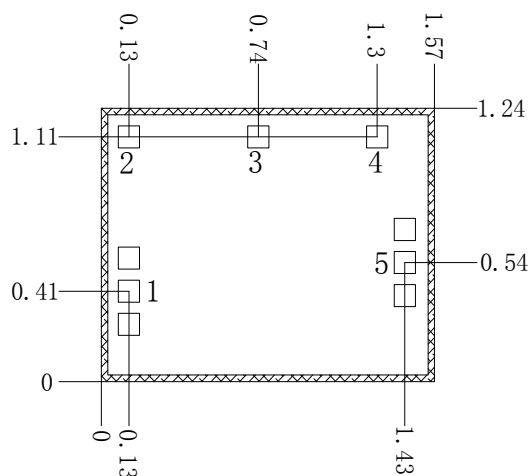
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注	
			MIN	TYP	MAX			
频率范围	f	VD=+5.0V Zin=Zout=50Ω	0.8		4	GHz		
增益	G		35	36		dB		
增益平坦度	ΔG			1	2	dB		
输入驻波	VSWRi				1.6	2		
输出驻波	VSWRo				1.6	2		
噪声系数	NF				1.4	2	dB	
输出 P ₋₁	P ₋₁			17	20		dBm	
输出 IP3	OIP3			27	30		dBm	
电压	VD			4.75	5	5.25	V	
电流	ID		VD=+5.0V		115	130	mA	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入电压	+6	V	最大输入功率	+18	dBm
贮存温度	-55~+150	°C			

芯片尺寸图:

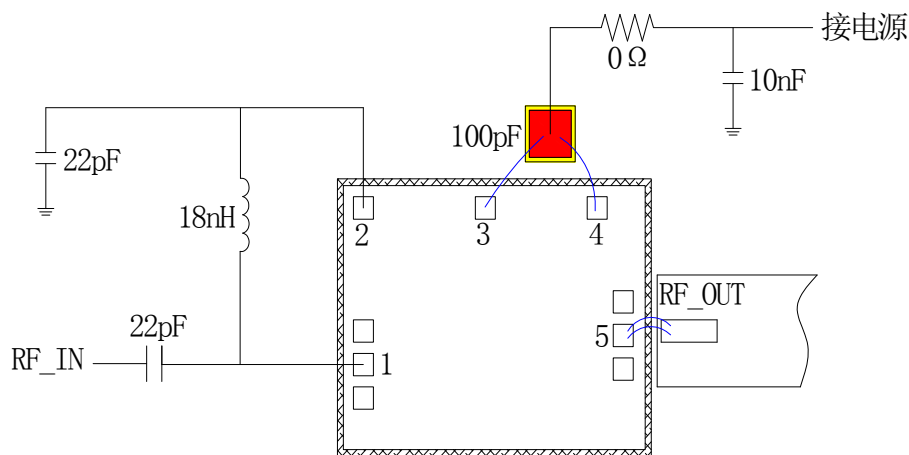
单位: mm



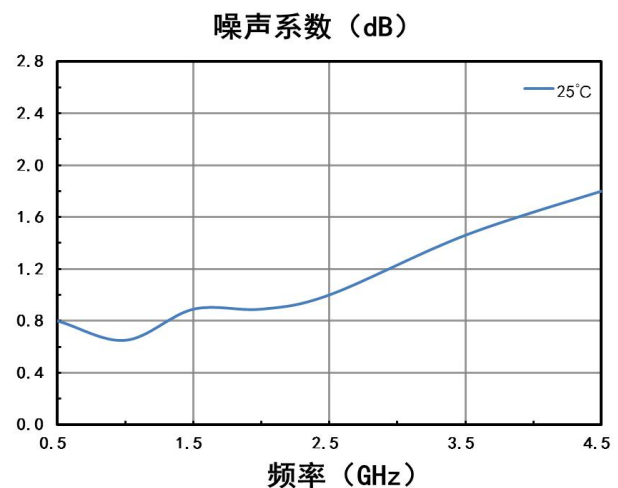
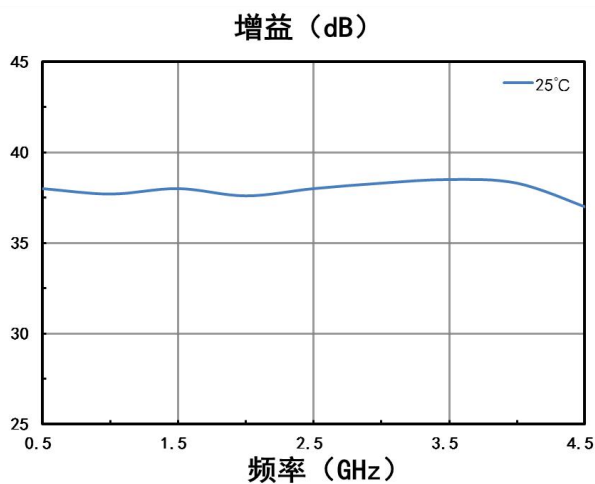
注: 典型键合焊盘尺寸为 100*100um

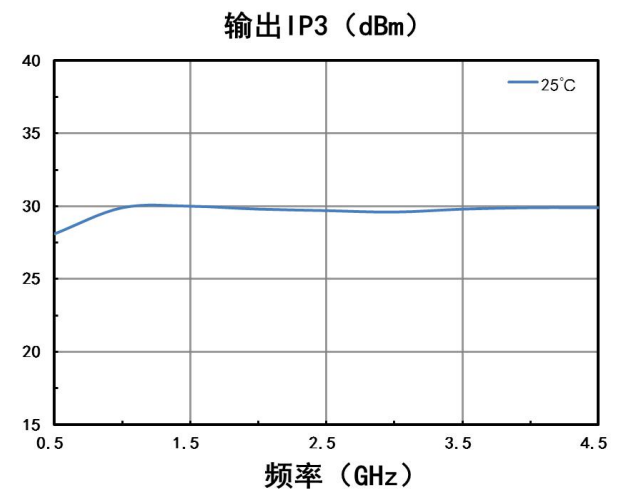
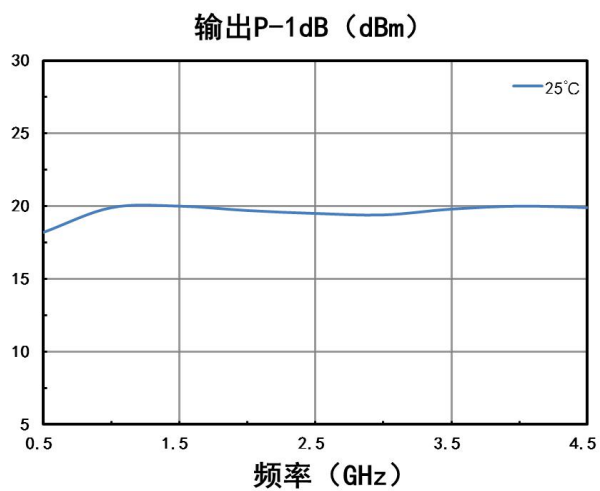
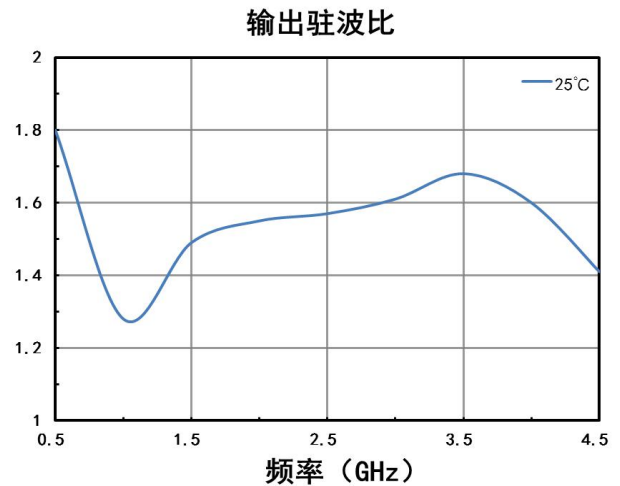
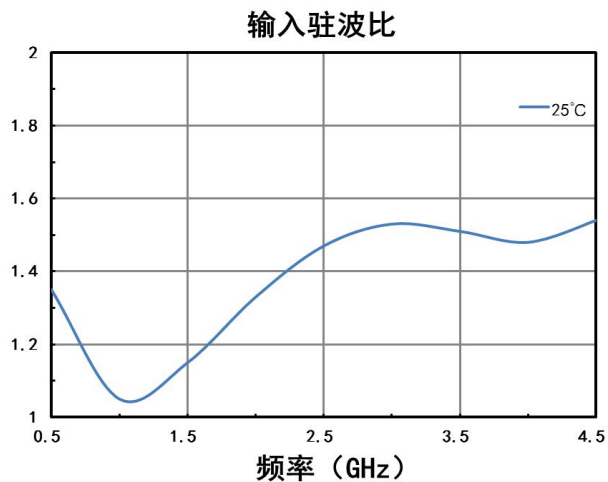
引脚定义:

引脚	定义	描述
1	IN	射频输入, DC 耦合, 需外接 22pF 隔直电容
2	Vbias	放大器偏置电压, 需外接 22pF 旁路电容
3, 4	VD	放大器电源电压, 需外接 10nF 和 100pF 旁路电容
5	OUT	射频输出, AC 耦合
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

推荐装配图:


注: 未标注的键合焊盘不需要连接

典型测试曲线:




产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。